

<<现代电子装联工艺基础>>

图书基本信息

书名：<<现代电子装联工艺基础>>

13位ISBN编号：9787560618159

10位ISBN编号：7560618154

出版时间：2007-5

出版时间：西安电子科技大学出版社

作者：余国兴

页数：250

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<现代电子装联工艺基础>>

### 内容概要

本书以现代电子产品装联工艺与材料为主，系统、全面地介绍了现代电子装联工艺的基础理论和工艺技术。

全书共十章，内容包括电子装联技术概论，现代电子装联的主要工艺流程，表面贴装元件，焊接工艺材料和焊接机理，装联可靠性基础，表面组装工艺（SMT）的印刷、贴片和回流焊技术，通孔插装工艺（THT）的波峰焊技术以及装联组件的清洗技术。

书中尤其突出了无铅焊接的基本内容。

本书可作为高等院校电子组装工艺方向的本科生教材，也可供电子产品制造业的工程技术人员参考。

## &lt;&lt;现代电子装联工艺基础&gt;&gt;

## 书籍目录

第1章 绪论 1.1 电子装联技术概述 1.1.1 基本概念 1.1.2 电子装联技术的地位 1.1.3 电子装联技术的基本内容 1.2 电子装联技术的发展过程 1.2.1 早期的装联技术 1.2.2 通孔插装技术 1.2.3 表面组装技术 1.2.4 微组装技术 1.3 电子装联工艺的研究内容 1.3.1 工艺的概念 1.3.2 电子装联工艺第2章 装联工艺流程 2.1 THT与SMT技术 2.1.1 THT技术 2.1.2 SMT技术 2.1.3 混装技术 2.2 组装类型 2.3 工艺流程 2.4 生产线组成第3章 表面贴装元器件 3.1 电阻器 3.1.1 矩形片式电阻器 3.1.2 圆柱形片式电阻器 3.1.3 片式电阻器的试验项目和方法 3.1.4 电阻网络 3.1.5 片式微调电位器 3.2 电容器 3.2.1 多层片式瓷介电容器 3.2.2 管形瓷介电容器 3.2.3 片式铝电解电容器 3.2.4 片式钽电解电容器 3.2.5 片式薄膜电容器 3.2.6 片式云母电容器 3.2.7 片式微调电容器 3.3 电感器 3.3.1 绕线型片式电感器 3.3.2 多层型片式电感器 3.3.3 卷绕型片式电感器 3.4 机电元件 3.4.1 轻触开关 3.4.2 片式旋转开关 3.4.3 片式滑动接触开关 3.4.4 钮子开关 3.4.5 表面组装继电器 3.4.6 连接器第4章 焊料合金 4.1 无铅化要求 4.1.1 无铅化趋势 4.1.2 对无铅焊料合金的总体要求 4.2 锡铅焊料合金 4.2.1 成分与类型 4.2.2 基本性能 4.2.3 组织与状态图 4.3 无铅焊料合金 4.3.1 概述 4.3.2 Sn—Ag系合金 4.3.3 Sn—Bi系合金 4.3.4 Sn—Cu系合金 4.3.5 Sn—Zn系合金 4.4 无铅焊料合金的基本性能 4.4.1 物理性能 4.4.2 机械性能 4.4.3 润湿特性 4.4.4 其它特性 4.5 工艺上的考虑 4.5.1 关于共晶合金 4.5.2 焊接工艺窗口 4.5.3 焊料合金的选择流程第5章 焊接机理第6章 材料性能与装联可靠性第7章 锡膏印刷与贴片第8章 回流焊工艺第9章 波峰焊工艺第10章 清洗工艺参考文献

<<现代电子装联工艺基础>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>